

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2023年9月28日(28.09.2023)



(10) 国際公開番号

WO 2023/182041 A1

(51) 国際特許分類:
G03F 7/004 (2006.01) *C08L 79/08* (2006.01)
C08K 3/013 (2018.01) *G03F 7/038* (2006.01)
C08K 3/36 (2006.01) *H05K 1/03* (2006.01)

(21) 国際出願番号: PCT/JP2023/009571

(22) 国際出願日: 2023年3月13日(13.03.2023)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願 2022-044940 2022年3月22日(22.03.2022) JP

(71) 出願人: 東レ株式会社 (TORAY INDUSTRIES, INC.) [JP/JP]; 〒1038666 東京都中央区日本橋室町2丁目1番1号 Tokyo (JP).

(72) 発明者: 桂田 悠基 (KATSURADA Yuki); 〒5208558 滋賀県大津市園山1丁目1番1号 東レ株式会社 滋賀事業場内 Shiga (JP). 瀧口 歩実 (TAKIGUCHI Ayumi); 〒5208558 滋賀県大津市園山1丁目1番1号 東レ株式会社 滋賀事業場内 Shiga (JP). 金森 大典 (KANAMORI Daisuke); 〒5208558 滋賀県大津市園山1丁目1番1号 東レ株式会社 滋賀事業場内 Shiga (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG,

SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第21条(3))

(54) Title: PHOTSENSITIVE RESIN COMPOSITION, PHOTSENSITIVE RESIN COMPOSITION FILM, CURED PRODUCT, AND ELECTRONIC COMPONENT USING SAME

(54) 発明の名称: 感光性樹脂組成物、感光性樹脂組成物フィルム、硬化物、これらを用いた電子部品

(57) Abstract: Provided is a photosensitive resin composition having excellent patterning property and providing excellent pressure resistance (elastic modulus) of a cured product. This photosensitive resin composition contains (A) a polyimide, (B) a cationic polymerizable compound, (C) a photocationic polymerization initiator, and (D) crystalline silica and has negative photosensitivity.

(57) 要約: 優れたパターン加工性を有し、硬化物の耐圧性(弾性率)に優れる感光性樹脂組成物を提供する。(A) ポリイミド、(B) カチオン重合性化合物、(C) 光カチオン重合開始剤、及び(D) 結晶性シリカを含有し、ネガ型の感光性を有する、感光性樹脂組成物である。

WO 2023/182041 A1